

	A 会場 (A201 号室)	B 会場 (AB02 号室)	C 会場 (A203 号室)
11:00	【1A1】実装材料—I 座長:菅沼克昭(大阪大学) 1. 三次元実装に向けたサーモトロピック液晶性ポリイミドの開発 ○村瀬友英, 相宗浩幸(三菱化学科学技術研究センター), 水谷文一(三菱化学), 荘司 優, 東原知哉, 上田 充(東京工業大学大学院) 2. 磁性複合材料シートを部材とした低背インダクターの開発 ○内木場文男(日本大学), 坂本晋一, 川原井 真, 大塚 努(スマタ電機) 3. 低温プロセスで作製した印刷金属パターンのデバイス応用 ○吉田 学, 末森浩司, 植村 聖, 星野 聡, 高田徳幸, 小笹健仁, 鎌田俊英(産業技術総合研究所)	【1B1】試験検査技術 座長:大塚邦顕(奥野製薬工業) 1. 電極間隔の狭ピッチ化に対応した微小結露試験方法の開発 ○田中浩和, 嶋田哲也(エスベック), 岡本 朗, 霞末和男, 岡田誠一(村田製作所) 2. マルチプローブを用いた微細プリント配線検査システムに関する研究 ○野口祐智, 斎藤之男, 角田興俊(東京電機大学) 3. ニューロ視覚検査システムの入力次元数検討と良否境界学習 ○副田 輝, 藤江裕之, 松嶋道也, 藤本公三(大阪大学大学院)	【1C1】鉛フリーはんだ—I 座長:藤原 裕(大阪市立工業研究所) 1. Sn ウィスカ成長に及ぼす Sn めっき構造と表面コート層の影響 ○金 種殊, 濱崎恭子, 李 奇柱, アローハン, 菅沼克昭(大阪大学), 辻本雅宣(上村工業) 2. 種々のめっきを施した鉛フリー半導体パッケージのはんだ付け実装のウィスカ評価 ○鈴木 聡, 小林晶子, 戸井恵子, 梶原隆志, 鈴木智也, 竹内 誠, 高橋邦明(エスベック) 3. 各種元素を添加した鉄基合金のはんだ浴中における溶食挙動 ○川本崇彰, 田中順一(北海道大学大学院), 山内 啓, 黒川一哉(北海道大学), 川久保 聡, 入澤 淳(弘輝)
12:00	昼休み		
12:50	【1A2】実装材料—II 座長:伊達仁昭(富士通研究所) 1. ウェハーレベルパッケージ用液状成型材の開発 ○大堀達也, 菅 克司(ナガセケムテックス), 西川雄(長瀬産業) 2. 先入れタイプのアンダーフィル材の成分と接続温度条件が接続信頼性に与える影響 ○奥野敦史, 有田良隆, 村中義和, 永井孝一良(サンエレクト), 坂井敏文, 土谷保史(アルファーデザイン) 3. シリコン系弾性導電性接着剤の電氣的挙動に及ぼすインターの影響 ○井上雅博, 菅沼克昭(大阪大学), 牟田浩明, 山中伸介(大阪大学大学院) 4. 狭ピッチ COF 用 NCF の開発 ○本田一尊, 榎本哲也(日立化成工業)	【1B2】バンブテクノロジー 座長:大塚邦顕(奥野製薬工業) 1. ガステポジション法により作製した錐形バンブの微小圧縮試験 ○居村史人, 仲川 博, 山地泰弘, 菊地克弥, 横島時彦, 馬場 創, 明渡 純, 青柳昌宏(産業技術総合研究所) 2. コンプライアントバンブ技術を用いた裏面照射型 CMOS イメージセンサーの開発 ○渡辺直也, 高尾隆之, 浅野種正(九州大学), 角田 功(九州工業大学), 田中康一郎(九州産業大学) 3. パワーデバイスの3次元実装に向けた微小金属保護層付き半導体 AI 電極 ○郎 豊群, 仲川 博, 青柳昌宏, 大橋弘通, 山口 浩(産業技術総合研究所) 4. Sn-Ag-Cu はんだ接合部の低サイクル疲労特性におよぼすサイズの影響 ○佐藤加奈(芝浦工業大学大学院), 浅利翔太, 菊谷義治(芝浦工業大学)	【1C2】鉛フリーはんだ—II 座長:竹本 正(大阪大学) 1. 多元 Sn-Ag 系はんだの組成が晶出相に与える影響 ○喜來省吾, 田中順一(北海道大学大学院), 山内 啓, 黒川一哉(北海道大学), 入澤 淳, 川久保 聡(弘輝) 2. Sn-Ag-Cu 三元系鉛フリーはんだの凝固過程の解析 ○鷹松喜子, 江坂久雄(防衛大学校) 3. レーザー顕微鏡による Sn-Ag 合金の凝固現象の直接観察 ○江坂久雄, 作田瑞穂, 鷹松喜子, 篠塚 計, 田村 学(防衛大学校)
14:10			

	A 会場 (A201 号室)	【セッション会場】
14:20	MES 2008 表彰式 ・ベストペーパー賞	A 会場: A201 号室
14:35	研究奨励賞	B 会場: AB02 号室
14:40	招待講演	D 会場: A203 号室
16:40	1. SMT と半導体パッケージング技術の融合による三次元 SiP モジュール化 藤津隆夫(J-SiP 代表取締役社長) 2. 高密度実装技術に貢献するめっき技術 小岩一郎(関東学院大学工学部教授)	C 会場: A101 号室

17:00	交流会 会 場: 福岡大学文系センター棟 16 階スカイラウンジ *参加費は別途必要です。
19:00	

	A会場 (A201号室)	B会場 (AB02号室)	C会場 (A203号室)	D会場 (A101号室)
9:15	<p>[2A1] 半導体パッケージ 座長: 天明浩之 (日立製作所)</p> <ol style="list-style-type: none"> 第4高調波 YAG レーザを用いた高密度配線基板の開発 ○原園正昭, 大吉隆文, 山中公博, 福井雅弘 (京セラ SLC テクノロジー) 無電解めっき法による貫通電極形成プロセスの開発 ○高橋信明, 小室雅宏, 松井 聡, 川野連也 (NEC エレクトロニクス) ウェハレベルプロセスによる新規小型パッケージの開発 ○東條 啓, 木谷智之, 樋口和人, 能木孝男, 大谷和己, 大谷忠夫 (東芝) 半導体パッケージ基板用無電解 Ni/Pd/Auめっき~ワイヤボンディング性に及ぼすめっき皮膜構成の影響~ ○江尻芳則, 長谷川 清, 櫻井健久, 坪末良明, 畠山修一, 有家茂晴 (日立化成工業) 	<p>[2B1] めっきテクノロジー 座長: 赤松謙祐 (甲南大学)</p> <ol style="list-style-type: none"> 電気銅めっき皮膜の物性におよぼす浴中添加剤の効果 ○松田光由 (宇都宮大学大学院工学研究科, 三井金属鉱業総合研究所), 高橋拓也, 吉原佐知雄 (宇都宮大学大学院), 土橋 誠 (三井金属鉱業) アルミバッド, 窒化膜, ポリイミド上への無電解めっきによるメタライゼーションの基礎的検討 ○配島雄樹, 金田龍馬, (関東学院大学大学院), 高木和希, (関東学院大学), 小岩一郎 (関東学院大学大学院, 関東学院大学) エキシマレーザーとめっき加工を適用した W-SP 法によるマルチチップモジュールの開発 ○和久田陽平 (野毛電気工業, 関東学院大学), 藤崎純史, 山田忠昭, 小岩一郎 (関東学院大学), 安藤 聡, 松野 明 (フェトン) ピアフィリングめっき用添加剤の新分析法の検討 ○橋本守人, 前田武昭, 西城信吾, 松浪卓史 (興野製業工業) 	<p>[2C1] 評価・設計技術 座長: 于 強 (横浜国立大学)</p> <ol style="list-style-type: none"> リードフレーム露出型パッケージのリフロー時における樹脂/フレーム界面強度評価 ○芦田喜章, 田中直敬 (日立製作所), 小池信也 (ルネサステクノロジー) 配線用銅薄膜の低サイクル疲労き裂発生および進展特性 ○張 聖徳, 坂根政男 (立命館大学), 寺田健司, 小坂 馨 (京セラ SLC テクノロジー) マイクロピット信頼性設計の一考察 ○大吉隆文, 藤崎昭哉, 一瀬 学, 山中公博 (京セラ SLC テクノロジー) 直接メタムル型燃料電池の構造および燃料供給量が触媒層温度へ及ぼす影響 ○清水悠矢, 杉村昌彦, 藤本公三 (大阪大学大学院) 	<p>[2D1] はんだ接合部寿命予測 座長: 江森雄二 (沖エンジニアリング)</p> <ol style="list-style-type: none"> Pbフリーはんだ BGA 接合部の衝撃耐性評価手法の検討 ○矢口昭弘, 谷江尚史, 中 康弘 (日立製作所), 山本健一, 木本良輔 (ルネサステクノロジー), 大野信忠 (名古屋大学) 複合負荷における車載コネクタのはんだ寿命予測解析手法の検討 ○吉田和弘 (住友電気工業), 土屋 隆 (住友電装), 坂田知之 (オートネットワーク技術研究所), 戸坂彰彦, 于 強 (横浜国立大学大学院) 車載電子デバイスのはんだ接合部における熱疲労寿命のパラメータ評価手法 ○丸岡敏明, 于 強, 澁谷忠弘 (横浜国立大学)
10:35	休憩			

10:45	<p>[2A2] 実装プロセス 座長: 頼 明照 (シャープ)</p> <ol style="list-style-type: none"> フリップチップ接続状態の改善のための高密度水素ラジカルによる Sn 酸化物除去技術 ○中島 毅, 和泉 亮 (九州工業大学大学院), 宮本幸宗, 佐藤 弘弘 (長瀬産業), 野北寛太 (北九州産業学術推進機構) Low-k 配線 TEG を用いた半導体パッケージ組立工程の評価 ○松本崇裕, 井本 睦, 崔 雲, 友景肇 (福岡大学), 森田 順 (ウォルツ), 堀内 登, 山田 毅 (福岡産業・科学技術振興財団) 銀-銅混合ナノ粒子を用いた低圧接合プロセス ○森貞好昭, 長岡 亨, 福角真男, 柏木行康, 山本真理, 中許昌美 (大阪市立工業研究所), 垣内宏之, 吉田幸雄 (大研化学工業) 薄型多層基板による曲面化成型プロセスの開発 ○小勝俊臣, 阿部勝巳, 藤井健一郎, 三上健介 (日本電気) 	<p>[2B2] 配線形成技術 座長: 福岡義孝 (ウェイスティー)</p> <ol style="list-style-type: none"> 感光性レジストフィルムを使用した LTCC 多層基板用キャビティ構造及びビア導体の作製方法 ○高藤美奈, 赤木陽介, 石垣克磨, 内木場文男 (日本大学) 感光性レジストフィルムを使用した平坦な微細配線が形成された LTCC 多層基板の作製方法 ○赤木陽介, 石垣克磨, 高藤美奈, 内木場文男 (日本大学) マイクロコンタクトプリンティングを用いた Silicone の ULSI 銅微細配線およびスタックドビア PWB 形成への応用 ○中嶋隆之, 鶴岡孝幸, 赤松謙祐, 縄母秀美 (甲南大学) ポリイミドフィルム上への ZnO のダイレクトパターンニング ○中道良太, 鶴岡孝幸, 赤松謙祐, 縄母秀美 (甲南大学), 松村康史 (新日鐵化学) 	<p>[2C2] 先端接続技術 座長: 上西啓介 (大阪大学)</p> <ol style="list-style-type: none"> ケミカル・フリップチップボンディング (I)-析出挙動の観察と FEM 解析 ○山田泰弘, 横島時彦, 菊地克弥, 仲川 博, 青柳昌宏 (産業技術総合研究所) ケミカル・フリップチップボンディング (II)-無電解 Au めっき併用プロセスによる特性改善 ○福島時彦, 山田泰弘, 菊地克弥, 仲川 博, 青柳昌宏 (産業技術総合研究所) はんだ含有接着剤を使用した低荷重 FPC on Board 接合技術の開発 ○本村耕治, 園尾弘樹, 水福秀喜 (パナソニック ファクトリーソリューションズ) 自己集合性を利用したはんだ接合工法の開発 ○幸崎清治, 北江孝史, 澤田 享, 中谷誠一 (川立大), 小山雅章, 塚原法人, 保手浜健一, 北出祐基 (パナソニック) 	<p>[2D2] MEMS テクノロジー 座長: 菅野京二 (京都大学)</p> <ol style="list-style-type: none"> 3次元微細構造担体を用いた高密度細胞培養 ○大向智也, 内海裕一 (兵庫県立大学), 木下 昂, 駒田寛之夫 (姫路獨協大学) 三次元遠心送液式マイクロ流体デバイスの送液挙動に関する検討 ○近藤沙紀, 浮田芳昭, 内海裕一 (兵庫県立大学) 積層型神経電極の作製 ○加藤崇彦, 内海裕一 (兵庫県立大学), Eric Blasius (カールスルーエ大学), 浮田芳昭 (兵庫県立大学, 日本学術振興会特別研究員 (PD)), 溝崎邦彦 (東京大学) アニマルウォッチ無線センサのための小型振動発電器に関する検討 ○中村公亮 (太陽誘電), 増田 蒼, 須賀唯知 (東京大学大学院), 伊藤寿浩 (産業技術総合研究所)
12:05	昼休み			

12:50	<p>[2A3] 接続信頼性 座長: 池田 徹 (京都大学)</p> <ol style="list-style-type: none"> 放射光 X 線 CT を応用した Fine pitch Ball Grid Array 鉛フリー接合部の熱疲労き裂の非破壊観察 ○約谷聡, 佐山利彦 (富山県工業技術センター), 岡本佳之, 高柳 毅 (コーセル), 上杉健太郎 (高輝度光科学研究センター), 森 孝男 (富山県立大学) 機械的せん断疲労試験による CSP 実装部の熱サイクル疲労寿命評価 ○神田喜彦, 座間邦宏 (芝浦工業大学大学院), 刈谷義治 (芝浦工業大学), 太田広徳 (日本電気), 菊池俊一 (富士通アドバンストテクノロジ), 山部英喜 (日本スベリア社), 中村一彦 (HDP User Group International Inc.) フリップチップパッケージにおける 1 次実装パンプの疲労信頼性におよぼす 2 次実装の影響 ○座間邦宏, 神田喜彦 (芝浦工業大学大学院), 刈谷義治 (芝浦工業大学), 佐藤敏行, 榎本利章, 平田康一 (ナミック) 耐エレクトロマイグレーション特性に優れたフリップチップはんだ接合部の開発 ○藤吉 優, 千綿伸彦, 若野基樹 (日立金属) エレクトロマイグレーションによるはんだ・銅微細接合部の組織変化 大竹康久, ○桑江伸明, 八坂健一, 上西啓介, 佐藤武彦 (大阪大学大学院), 赤松俊也, 作山誠樹 (富士通研究所) 	<p>[2B3] LED 実装技術 座長: 西田秀行 (ニシダエレクトロニクス 実装技術支援)</p> <ol style="list-style-type: none"> 近紫外励起白色発光 LED の積層構造による発光特性の変化 ○片岡思温, 大城悟司, 榎原靖彦, 倉井 聡, 田口常正 (山口大学大学院), 内田裕士, 加藤一久 (山口大学) 近紫外 LED 励起発光体のパッケージ内配置構造による発光特性のシミュレーション評価 ○林 秀樹, 竹下淳一, 倉井 聡, 田口常正 (山口大学大学院), 内田裕士 (山口大学) 発光体積層型 LED 光源による発光効率の発光体配置依存性 ○竹下淳一, 加門邦人, 林 秀樹, 倉井 聡, 田口常正 (山口大学大学院), 内田裕士 (山口大学) 直接フリップチップ接合を用いた高光出力高集積 LED における放射効率的実装密度依存性 ○加門邦人, 竹下淳一, 倉井 聡, 田口常正 (山口大学大学院), 内田裕士 (山口大学) 近紫外励起白色発光 LED における信頼性評価 ○大城悟司, 片岡思温, 榎原靖彦, 倉井 聡, 田口常正 (山口大学大学院), 内田裕士, 加藤一久 (山口大学) 	<p>[2C3] 高速・高周波の実現—I 座長: 井上博文 (日本電気)</p> <ol style="list-style-type: none"> バンドパスフィルタを内蔵した高周波プローブ System with Probe (SwP) ○松本圭司, 齊藤亮太, 崔 雲, 友景肇 (福岡大学大学院) エバーネット波エネルギーを利用した高速長距離信号伝送に関する研究 ○河野一雄, 秋山 豊, 菊地 久, 大塚寛治 (明星大学) 特性インピーダンス 50Ω を一定にした伝送線路における断面寸法変化の直流抵抗と伝送特性 ○河野一雄, 秋山 豊, 藤井文明, 橋本 薫, 菊地 久, 大塚寛治 (明星大学) 最適化アルゴリズムを用いた車載電子機器のコモンモードノイズ低減技術 ○鶴生高徳 (デンソー, 静岡大学), 岡崎勇治, 浅井秀樹 (静岡大学) 	
14:30	休憩			

14:40	<p>[2A4] 部品内蔵技術 座長: 江間富世 (パナソニックモバイル コミュニケーションズ)</p> <ol style="list-style-type: none"> はんだ粒子含有ペーストを用いた部品内蔵基板の実装評価 ○園尾弘樹, 水福秀喜, 本村耕治, 境忠彦 (パナソニックファクトリーソリューションズ) キャビティ付き部品内蔵配線基板の開発 ○宮崎政志, 横田英樹, 片貝正史, 杉山祐一, 齋渡達郎, 柳瀬 信, 宮崎正和 (太陽誘電) 多ピン LSI 内蔵薄型パッケージ基板の電気設計及び動作実証 ○大島大輔, 森 健太郎, 菊池 克, 中島嘉樹, 山道新太郎 (日本電気) 多ピン LSI 向け薄型, 高放熱 LSI 内蔵パッケージ ○森 健太郎, 大島大輔, 菊池 克, 中島嘉樹, 山道新太郎 (日本電気) 	<p>[2B4] 信頼性設計 座長: 馬場和宏 (日本電気)</p> <ol style="list-style-type: none"> 半導体ナノデバイス内部の応力分布を考慮したデバイスシミュレーション ○吉田圭佑, 池田 徹, 宮崎則孝 (京都大学大学院), 小倉正明 (福岡県工業技術センター), 友景 肇 (福岡大学) はんだ接合積層構造の熱ラチェット反り変形 ○谷江尚史, 矢口昭弘 (日立製作所), 大野信忠, 中根和彦 (名古屋大学) ランダム分光法を用いたワイヤボンディング部合金化による応力状態評価 ○鈴木亜紀, 杉江隆一, 吉川正雄, 伊藤元剛, 吉川正信 (東レリサーチセンター) 導電性接着剤の実装状態を考慮した熱伝導率測定技術 ○平田祐哉, 田中浩和 (エスベック), 柳浦 聡 (三菱電機), 渡邊 聡 (藤倉化成), 大串哲朗 (広島国際大学) BGA パッケージはんだ接合部の熱疲労寿命についての考察 ○伊藤元剛, 的場伸啓, 平野孝行, 三橋和成, 石切山一彦 (東レリサーチセンター) 	<p>[2C4] 高速・高周波の実現—II 座長: 田中顕裕 (アイカ工業)</p> <ol style="list-style-type: none"> プリント回路基板技術を用いた同軸型ビア接続構造に関する検討 ○高須隆之, 青柳昌宏 (東京理科大学, 産業技術総合研究所), 越地耕二 (東京理科大学), 菊地克弥, 仲川 博 (産業技術総合研究所) 右子/左子系複合線路を用いたコプレーナ型バックワードコプラ ○勝又雅基, 青木広由, 越地耕二 (東京理科大学大学院) 人工誘電体の等価比誘電率特性の検討 ○杉本敦史, 青木広由, 越地耕二 (東京理科大学) 高密度配線基板による高速信号伝送設計へのアプローチ ○中村 聡, 一瀬 学, 山中公博 (京セラ SLC テクノロジー) 電磁界解析を用いた放射ノイズ評価システムの精度向上へ向けた基礎検討 ○菊地克弥, 仲川 博, 青柳昌宏 (産業技術総合研究所・東京理科大学大学院), 星 敦司, 越地耕二 (東京理科大学) 	
16:20	休憩			